

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2022-051

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于实施建设产业园项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：“半导体科创产业生态园”建设项目
- 投资金额：项目投资预算为人民币 4.1058 亿元

一、项目概述

为进一步发挥公司产业资源优势，持续做专做强，公司计划现在自有经营地块上实施“半导体科创产业生态园”建设项目（以下简称“项目”），以推进公司的未来战略发展需求，项目规划占地面积 90 亩，建设总面积约 12 万平方米，总投资规模 4.1 亿元人民币，项目建设不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、项目具体情况

项目实施地址：苏州工业园区方洲路 155 号（公司长阳厂区），规划占地面积约 90 亩

项目建设内容：规划建筑总面积约 12 万平方米，其中研发用综合楼约 3 万平方米，厂房与生产配套约 9 万平方米

项目建设期间：2022 年 10 月至 2024 年 7 月

项目总承包方：苏州二建建筑集团有限公司

项目预算：4.1058 亿元人民币

三、项目实施目的

通过实施建设产业园项目，将从以下方面推进公司未来战略创新发展需求：

1、围绕主业发展打造产业生态链。依托既有技术与市场资源优势，着力将自身发展所需的上、下游企业导入产业园，为公司的技术与产业发展进行定制化的设备、材料与工艺开发，围绕主业形成产业链生态圈；2、聚焦车规半导体技术搭建创新产业孵化平台。通过聚合车规半导体产业技术研究所共建方的资源，搭建涵盖研发，设计，测试的一体化综合服务平台，着力引进、孵化、投资新的优秀团队与技术项目，拓展新的产品与市场；3、推进国际并购项目的产业移植与规模商业化。项目将为公司车规级微型光学器件项目的进一步扩大生产规模、车规级氮化镓逆变器项目的产业链布局提供有效的生产性资源与产业支撑。

四、项目实施风险

项目符合国家、地方各项产业、环保政策，项目实施能有效保障公司未来战略发展需求，推动公司的持续创新发展。

项目的实施可能会受宏观经济、产业政策、行业周期与市场环境等因素影响，并对项目的实施进度与效果等带来不确定性风险，公司将积极协同项目总包方、监理方等各方资源，有效推进项目建设的顺利实施，降低投资风险。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2022年10月31日